

審決

不服 2012- 225

ドイツ国、01561 ザッカ、ズースーストラーセ、1
請求人 カスケード・マイクロテク・ドレスデン・ゲゼル
シャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング

東京都港区虎ノ門二丁目8番1号 虎の門電気ビル 江崎特許事務所
代理人弁理士 江崎 光史

東京都港区虎ノ門二丁目8番1号 虎の門電気ビル 江崎特許事務所
代理人弁理士 鍛冶澤 實

東京都港区虎ノ門二丁目8番1号 虎の門電気ビル 江崎特許事務所
代理人弁理士 今村 良太

東京都港区虎ノ門二丁目8番1号 虎の門電気ビル 江崎特許事務所
代理人弁理士 清田 栄章

特願2004-249234「基板を検査する装置」拒絶査定不服審判事
件〔平成17年 4月14日出願公開、特開2005-101584〕につ
いて、次のとおり審決する。

結 論

本件審判の請求は、成り立たない。

理 由

第1. 手続きの経緯

本願は、平成16年8月27日の外国語書面出願（パリ条約による優先権
主張 2003年8月28日、独国）であって、平成16年9月17日付け
で明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書の翻訳文が提出され、平成22
年5月28日付けで拒絶理由が通知され、平成22年12月17日付けで意
見書及び手続補正書が提出されたが、平成23年8月10日付けで拒絶査定
がなされた。これに対し、平成24年1月6日に審判請求がなされるととも
に、同日付けで手続補正書が提出されたものである。

第2. 平成24年1月6日付けの手続補正書による補正の却下の決定

〔補正却下の決定の結論〕

平成24年1月6日付けの手続補正書による補正を却下する。

〔理由〕

1. 補正の内容

上記手続補正書により補正された特許請求の範囲のうち、請求項1に係る
発明は、以下のとおりのものである。

「【請求項1】

基板を検査する装置であって、この装置は、ハンドリングシステム（3）、
基板マガジンステーション（7）及び整合ステーション（10）を有する検
査機を有する装置において、ハンドリングシステム、基板マガジンステ
ーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも2
つの検査機（1；2；11；12；14；15）が提供されていること、

各検査機（１；２；１１；１２；１４；１５）は、独立したモジュールとして構成されていること、および、
各モジュールは、同じサイズの格子寸法であり、各モジュールは、互いに接合され得ること、および、
各モジュールは、振動絶縁部、又は、位置制御されるプラットフォーム上に配置されていることを特徴とする装置。」

２．補正の適否

（１）補正の内容及び補正の目的に係る要件

上記請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明」という。）は、補正前の請求項１の「各モジュール」について「振動絶縁部、又は、位置制御されるプラットフォーム上に配置されている」ことを限定するものであり、この補正は、補正前の請求項１に記載された発明を特定するために必要な事項を限定するものである。

したがって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という）第１７条の２第４項第２号に規定された特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

そこで、本願補正発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するか否か）について、以下に検討する。

（２）刊行物の記載事項

ア．これに対して、本願の優先日前に頒布された刊行物である国際公開第０１／８０２８９号（以下、「刊行物１」という。）には、「MODULAR SUBSTRATE MEASUREMENT SYSTEM（モジュール式基板測定システム 以下、英文の後の日本語文は当審による和訳。）」（発明の名称）について、図面とともに下記の事項が記載されている。

（ア１）「The present invention provides a substrate measurement system comprising a central substrate handling chamber which is provided with substrate transfer means, at least one substrate container interface with a standardised interface and arranged to receive a matching substrate container, and a mechanical interface to receive a measurement chamber comprising a measurement instrument. The measurement chamber has a standardised size and is provided with standardised mechanical interface, in order to connect to the corresponding interface of the substrate handling chamber. Because of the standardisation of the measurement chamber, the modular substrate measurement system can easily be configured with different types of measurement instruments for a certain application by a simple replacement of one measurement chamber by another chamber.

According to a preferred embodiment of the present invention, the central substrate handling chamber comprises two or more measurement chambers of standardised size and provided with a standardised mechanical interface. In this embodiment, the substrate transfer means are shared by the two or more measurement instruments inside their respective measurement chambers and the substrate container interface, resulting in savings in cost and floor space. Moreover, two or more measurements on a single wafer can be executed sequentially without time delay. In this embodiment, more than one substrate container interface can be connected to the substrate handling chamber. The measurement chambers can be distributed in a substantially horizontal plane but they can also be stacked in a substantially vertical direction.（１頁２６行～２頁１６行）

（本発明は、基板移送手段、標準化されたインターフェースを有しかつ適合

している基板容器を受け入れるように配列された少なくとも１個の基板容器インターフェース、及び測定装置を備えている測定室を受け入れるための機械式インターフェースが設けられた中央基板操作室を備えた基板測定システムを提供する。測定室は、標準化された寸法を有しかつ基板操作室の対応するインターフェースと連結するために、標準化された機械式インターフェースが設けられる。測定室の標準化のため、モジュール式基板測定システムは、ある測定室を別の室に単純に置換することにより、ある特定の用途のための種々の形式の測定装置を用いて容易に構成することができる。

本発明の好ましい実施例により、中央基板操作室は、標準寸法の２個以上の測定室を備え、標準の機械式インターフェースが設けられる。この実施例においては、基板移送手段は、それぞれの測定室内部の２個以上の測定装置及び基板容器インターフェースに共有され、価格及び床空間の節約をもたらす。更に、１個のウエハー上の２個以上の測定を時間遅延なしに続けて行うことができる。この実施例においては、１個以上の基板容器インターフェースを基板操作室に連結することができる。測定室は、実質的に水平面上に分布させることができるが、これを実質的に垂直方向に積み重ねることもできる。）」

(ア２) 「Figure 1 shows a substrate measurement system comprising a centrally mounted substrate handling chamber 7, provided with wafer transfer means 10. The substrate handling chamber is provided with a substrate container interface 1 and a mechanical interface 50 on which a measurement chamber 30 is connected. Substrate container interface 1 is connected to substrate handling chamber 7. On substrate container interface 1 a substrate container 8 is mounted. Substrate container interface 1 provides a standardised mechanical interface on which the substrate container 8 is connected by means of a corresponding interface.

In the measurement chamber 30 a measurement instrument 35 is provided for a certain application, e.g. measurement of the thickness of a film on a wafer. Both substrate handling chamber 7 and measurement chamber 30 comprise standardised mechanical interfaces: the mechanical interface 50 provided on the substrate handling chamber 7 and the matching interface 51 on the measurement chamber 30 are standardised.

The mechanical interface 50 and the matching interface 51 both provide matching coupling parts 52, and 53, respectively, for coupling the measurement chamber 30 to the substrate handling chamber 7. The coupling provides a gastight sealable coupling between the measurement chamber 30 and the substrate handling chamber 7. In this manner, the measurement chamber 30 can be used under controlled vacuum pressure conditions. Also, the mechanical interface 50 provides a mechanical support area 54 for supporting the measurement chamber 30 on a matching support area 55 of the mechanical interface 51. The support areas 54, 55 may be arranged as a substantially horizontal area, a substantially vertical area, or a combination of both. The fit of such a mechanical support area 54 and a matching support area 55 may be provided in any conceivable way as known in the art. (３頁２２行～４頁１５行)

(図１は、ウエハー移送手段１０が設けられかつ中央に取り付けられた基板操作室７を備えた基板測定システムを示す。基板操作室には基板容器インターフェース１及び機械式インターフェース５０が設けられ、これに測定室３０が連結される。基板容器インターフェース１は基板操作室７に連結される。基板容器インターフェース１には基板容器８が取り付けられる。基板容器インターフェース１は標準的な機械式インターフェースを提供し、これに、基板容器８が、対応インターフェースの手段により連結される。

測定室３０には、ある種の用途、例えばウエハー上の薄膜の厚さの測定の

ための測定装置 35 が設けられる。基板操作室 7 及び測定室 30 の両者は標準の機械式インターフェースを備える。基板操作室 7 に設けられた機械式インターフェース 50 及び測定室 30 の機械式インターフェース 51 は標準化される。

機械式インターフェース 50 及び機械式インターフェース 51 の両者は、測定室 30 を基板操作室 7 と結合させるために、それぞれ適合した結合用部分 52 及び 53 を備える。この結合は、測定室 30 と基板操作室 7 との間の気密封鎖可能な結合を提供する。この方法で、測定室 30 を、管理された真空条件下で使うことができる。また、機械式インターフェース 50 は、機械式インターフェース 51 の適合している支持区域 55 上で測定室 30 を支持するための機械式支持区域 54 を提供する。支持区域 54、55 は、実質的に水平な区域として、実質的に垂直な区域として、或いは両者の組合せとして配列することができる。かかる機械式支持区域 54 と適合支持区域 55 との適合は、本技術において知られる適宜の想像し得る方法で提供することができる。)

(ア 3) 「The substrate transfer means are capable of transferring a substrate from any of the substrate containers 8,9, located on substrate container interfaces 1,2, by means of their interfaces 80,81, in any required sequence along any number of the measurement chambers 30,31,32,33 and of returning the substrate in either, the same substrate container or the other substrate container, respectively.

During measurement of a substrate in any of the measurement instruments 35,36,37, 38, located in one of the measurement chambers 30,31,32,33, the substrate can be supported by the substrate transfer means 10. But, most preferably, the substrate is supported on substrate support means (not shown) inside the measurement chamber 35,36,37,38 and the substrate transfer means 10 are retracted from the measurement chamber 30,31,32,33. In this way, during measurement of one substrate in one measurement instrument, the substrate transfer means 10 is available to transfer other substrates to and from one of the other measurement instruments. The substrate handling chamber 7 can also be equipped with a station for substrate aligning or for substrate identification, as known in the art. (5 頁 18 ~ 32 行)

(基板移送手段は、基板を、基板容器インターフェース 1、2 に置かれた基板容器 8、9 のいずれからも、それらのインターフェース 80、81 により、任意の数の測定室 30、31、32、33 に沿っていかなる要求された順序においても移送することができ、更に基板を同じ基板容器か又は別の基板容器のどちらにも戻すことができる。

測定室 30、31、32、33 の一つに置かれた測定装置 35、36、37、38 のいずれにおける基板の測定中も、基板は、基板移送手段 10 により支持される。しかし、基板が測定室 35、36、37、38 内の基板支持手段(図示せず)上に支持され、基板移送手段 10 が測定室 30、31、32、33 から後退させられることが最も好ましい。この方法で、1 測定装置における 1 基板の測定中に、別の基板を別の測定装置に出し入れするために移送するように基板移送手段 10 を使うことができる。

基板操作室 7 には、本技術において知られるように、基板整列用又は基板識別用のステーションも設けることができる。)

(ア 4) 「Figure 3 shows a modular substrate measurement system according to a third embodiment wherein the substrate container interfaces 1,2,3 and the measurement chambers 30,31 32 are grouped in linear arrays around an elongated substrate handling chamber 7. Between substrate handling chamber and measurement chambers, mechanical interfaces 50 and 51 are provided as described in the

previous embodiments. On the substrate container interfaces 1, 2, 3 substrate containers 8, 9, 11 are mounted. The substrate transfer means 10 comprise means for a linear translation in the substantially longitudinal direction of the substrate handling chamber 7, as indicated by the arrows T1 and T2.

In the embodiment of Figure 3, due to the standardised mechanical interfaces 50 and 51, each measurement chamber 30, 31, 32 can easily be replaced by one of a plurality of other measurement chambers 39, 40, that are each provided with its respective measurement instrument 41 or 42, specific to the desired application. Also, due to the standardised mechanical interfaces 50 and 51, the measurement chambers 30, 31, 32 can be mutually exchanged in any way selected. (6 頁 8 ~ 22 行)

(図3は、第3の実施例によるモジュール式基板測定システムを示し、このシステムにおいては、基板容器インターフェース1、2、3及び測定室30、31、32が、長い基板操作室7の周りの直線状アレイにグループ化される。基板操作室と測定室との間に、前述実施例において説明されたように機械式インターフェース50及び51が設けられる。基板容器インターフェース1、2、3上に基板容器8、9、11が取り付けられる。基板移送手段10は、矢印T1及びT2で示されるように、基板操作室7の実質的に長手方向で直線状に移送するための手段を備える。

図3の実施例においては、標準化された機械式インターフェース50及び51により、各測定室30、31、32は、希望の用途に特定されたそれぞれの測定装置41又は42が設けられた複数の他の測定室39、40の一方と容易に置換することができる。また、標準化された機械式インターフェース50及び51のため、測定室30、31、32は、適宜の選ばれた方法で互いに交換することができる。)

(ア5) 「In this way the outside dimensions of the measurement chamber need to be only slightly larger than the dimensions of the substrate to allow mapping of the wafer. When the substrate is circular, with a diameter of 300 mm or greater, the measurement chamber can fit within a horizontal square or rectangular cross section with the smallest dimension less than 100 mm larger than the substrate diameter. For the compactness of the system it is advantageous to have this smallest dimension at the side that is mounted against the substrate handling chamber.」 (10 頁 11 ~ 17 行)

(この方法で、ウェハーのマッピングを許すための測定室の外側寸法は、基板の寸法より僅かに大きいことしか必要ない。基板が直径300mm又はそれ以上の円形である場合は、測定室は、基板直径より最大で100mm大きい最小寸法の水平方向正方形又は長方形内に適合できる。システムの小型化のために、基板操作室に対して取り付けられる側がこの最小寸法を持つことが有利である。)

(ア6) 図3の記載から、直方体の測定室30、測定室31及び測定室32が、互いに平行に基板操作室7に接続されていることが看取できる。

上記の摘記事項からみて、刊行物1には下記の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。

「基板移送手段、基板容器インターフェース、基板整列用のステーション及び測定装置を備える2個以上の測定室を有するモジュール式基板測定システムにおいて、基板移送手段は、基板を、基板容器インターフェース中に設けられた基板容器から任意の測定室に移送することができ、測定室は標準化された寸法を有する直方体であり、他の測定室に置換可能とするとともに機械式支持区域に支持され、さらに、複数の測定室が互いに平行に基板操作室に対して接続された、モジュール式基板測定システム。」

イ. 同じく、本願の優先日前に頒布された刊行物である特開昭
61-168236号公報（以下、「刊行物2」という。）には、「ウェハ
検査装置」について、図面とともに下記の事項が記載されている。

（イ1）「（発明の背景）

従来、ウェハ検査装置を2台並べ、1台のテスター装置により各ウェハ検
査装置を制御することは知られている。しかしながら上述した各ウェハ検査
装置は、ウェハを検査する為にファインアライメント可能なステージ機構の
他に、該ステージ機構へウェハを導びく為のローディング機構をそれぞれ備
えていたので、設置床面積が非常に大きくなるという欠点があった。

（発明の目的）

本発明はこのような欠点を解決し、複数のステージ機構によりウェハを検
査できるとともに設置床面積の小さなウェハ検査装置を提供することを目的
とする。」（第1頁左下欄下から8行～同右下欄第6行）

（イ2）「第1図はケーシング内のウェハ検査装置を上から見た場合の概略
的平面図、第2図はケーシング内のウェハ検査装置の特にステージ部分を示
す正面図、第3図はウェハ検査装置のローディング機構を示すA-A矢視
図、第4図はマイクロコンピュータの動作を表わすフローチャートである。

第2図において1は架台部、2及び3は架台部1上にそれぞれ別個独立に
設けられた防振機構である。ベース4は防振機構2上に固定されている。」

（第1頁右下欄第10行～同第18行）

（イ3）「本実施例では以上述べた要素4～7、9～11、13にて右側検
査部が構成されている。ベース14、XYステージ15、Zステージ16、
 θ 回転ステージ17、プローブカード19、支持台20、顕微鏡21、セン
サ22はそれぞれ右側検査部の要素4～7、9～11、13と同様に構成さ
れており、左側検査部を構成している。18は θ 回転ステージ上に配置され
たウェハを示している。上述した右側検査部と左側検査部とは架台部1上に
独立して設けられた防振機構2、3にそれぞれ支持されており、この防振機
構2、3により相互に振動が伝達されないよう構成されている。」（第2頁
右上欄第5行～同第17行）

（イ4）「ウェハのプリアライメントを行なう為のステージ45はモータ
44によって回転（自転）可能である。」（第2頁右下欄第10行～同第
12行）

ウ. 同じく、本願の優先日前に頒布された刊行物である特開
2000-183129号公報（以下、「刊行物3」という。）には、「真
空処理システム」について、図面とともに下記の事項が記載されている。

（ウ1）「【0069】共通搬送室71は矩形形状を有し、図6図示の例で
は5室からなる真空処理室73a～73eは、共通搬送室71の一側面に
沿って共通搬送室71の長手方向中心軸に対して平行に配列される。また、
ロード室74、アンロード室75、及び台車室76は、真空処理室
73a～73eと対向する他側面に沿って共通搬送室71の長手方向中心軸
に対して平行に配列される。

【0070】このため、共通搬送室71は、上記一側面の5箇所及び上記他
側面の3箇所にゲート弁79を装着するための開口及び取付け座が形成され
る。全ての開口及び取付け座は同一寸法に設定され、いずれの取付け座に
も、同一寸法及び同一規格のゲート弁79を介して室73a～73e、
74、75、76を選択的に取付けることができる。

【0071】共通搬送室71の床72上に配設された移動手段の一例として
のレール29（図2参照）は、搬送装置20e、20f、20gがX及びY
方向へ移動できるように設計される。即ち、搬送装置20e、
20f、20gは、図4及び図5図示の如く、 θ 方向に回転されることな
く、X及びY方向へ直線的に移動されることにより、各室73a～73e、
74、75、76への搬送ラインへ合致するよう操作される。

【００７２】図６図示の処理システム７０によれば、図４図示の処理システム５０で得られる効果に加え、搬送装置の回転の動作が不要であるため、共通搬送室７１の大きさを、搬送装置がＸ及びＹ方向への移動を行うに必要な最小限のものとすることができる。また、図４図示の放射状の配置に比べ、真空処理室７３ａ～７３ｅ間のスペースの無駄がないため、設置スペースの低減が可能となる。」

（ウ２）また、図６の記載から、真空処理室７３ａ～７３ｅが、それぞれ同一形状の区画として形成され、互いに隙間なく配置されて共通搬送室７１に接続されていることが看取できる。

（３）対比・判断

本願補正発明と引用発明を対比すると、引用発明の「基板移送手段」、「基板容器インターフェース」、「測定室」及び「測定装置」、「モジュール式基板測定システム」は、それぞれ本願補正発明の「ハンドリングシステム」、「基板マガジンステーション」、「検査機」、「基板を検査する装置」及び「装置」に相当する。

また、引用発明の「測定室」は標準化された寸法を有する直方体であり、他の測定室に置換可能であるから、個々の測定室は互いに同じサイズの格子寸法を有しているといえる。

そして、半導体基板等の基板を検査する場合、検査装置に搬入する前に、基板の方向や位置を整合させるために、基板を整列させる領域へ搬送手段により搬送することは、刊行物２（プリアライメントを行なう為のステージ４５）に記載されているように周知であって、当業者が当然採用する技術的事項であるから、引用発明の「基板整列用のステーション」は、本願補正発明の「整合ステーション」に相当し、引用発明の基板移送手段は、基板を基板整列用のステーションに搬送することは明らかである。

さらに、本願明細書の段落【００１２】～【００１３】に「【００１２】この課題は、本発明により、ハンドリングシステム、基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも２つの検査機が提供されていることによって解決される。

【００１３】

それ故に、ウェハーマガジンが、基板マガジンステーションによって使用され得る。検査用の半導体ウェハが、このウェハーマガジンによって全ての検査機に供給される。この場合、このハンドリングシステムは、半導体ウェハをウェハーマガジンから取り出し、このウェハを予備位置決めのために整合ステーション上に設置する。この半導体ウェハは、予備位置決め後に再び持ち上げられて検査機に送られる。」と記載されているように、本願補正発明の「ハンドリングシステム、基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも２つの検査機」とは、ハンドリングシステムにより基板を基板マガジンステーションから検査機や整合ステーションに供給することを意味しているから、引用発明において、基板移送手段によって基板容器インターフェースから測定室や基板整列用のステーションへ基板を移送することは、本願補正発明の「ハンドリングシステム、基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも２つの検査機」に相当するものといえる。

したがって、本願補正発明と引用発明は、
「基板を検査する装置にあって、この装置は、ハンドリングシステム、基板マガジンステーション及び整合ステーションを有する検査機を有する装置において、ハンドリングシステム、基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも２つの検査機が提供されている、装置」で一致し、下記の点で相違する。

・相違点１

本願補正発明の装置が、各検査機は独立したモジュールとして構成され、各モジュールは同じサイズの格子寸法であり、各モジュールは互いに接合さ

れ得るのに対し、引用発明のモジュール式基板測定システムは、測定室が標準化された寸法を有する直方体であり、他の測定室に置換可能とされているものの、機械式支持区域に支持され、個々の測定室は互いに接合され得るとは特定されていない点。

・相違点 2

本願補正発明の装置が、各モジュールは、振動絶縁部、又は、位置制御されるプラットフォーム上に配置されているのに対し、引用発明のモジュール式基板測定システムは、振動を絶縁する手段を備えるとは特定されていない点。

そこで、上記相違点について検討する。

・相違点 1 について

基板を処理する装置や検査装置は、一般にクリーンルーム等の清浄空間に設置され、それらの設置空間が小さい方が望ましいことは、当業者にとって自明の事項である。

また、複数のモジュール化された処理室を平行に配置して、基板を搬送する共通する基板搬送室に対して連結するような場合、装置全体の設置スペースを低減するために、処理室間の隙間を無くして接合し得るように配置することは、刊行物 3 に示されているように、基板処理装置の技術分野において当業者が適宜採用する配置手法であるといえる。

そして、引用発明の基板移送手段を設けた基板操作室に 2 個以上の測定室を互いに平行に接続したモジュール式基板測定システムにおいても、モジュール式基板測定システムの設置空間を減らそうとすることは、当業者であれば当然考慮するはずであるから、刊行物 3 に記載された上記の配置手法のように、平行に配置された同一寸法のモジュール間の隙間を出来る限り減らして、互いに接合され得るように配置することは、当業者が容易に想到し得たものである。

・相違点 2 について

半導体ウエハを搬送する装置に対して複数の検査装置を配置する際に、検査装置それぞれを防振機構上に配することは、刊行物 2 に記載されているように周知の技術的事項である。

半導体ウエハ等の基板を測定装置により測定し検査する際に、測定装置が振動を拾ってしまうと基板の検査が正確にできないことは当業者にとって自明の事項であり、引用発明のモジュール式基板測定システムにおいても、基板の測定を正確に行うために、測定室に振動を絶縁する防振機構を設けることは、当業者が容易に想到し得たものである。

そして、本願補正発明により奏される効果は、引用発明及び上記周知の技術的事項から容易に予測できるものである。

以上のとおり、本願補正発明は、引用発明及び周知の技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

(4) 結論

よって、本件補正は、平成 18 年改正前特許法第 17 条の 2 第 5 項において準用する同法第 126 条第 5 項の規定に違反してなされたものであるから、同法第 159 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 53 条第 1 項の規定により却下すべきものである。

第 3. 本願発明について

1. 本願発明

平成 24 年 1 月 6 日付けの手續補正書による補正は上記のとおり却下され

たので、本願の請求項に係る発明は、平成２２年１２月１７日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１ないし９に記載された事項により特定されたものであり、そのうち、請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、以下のとおりのものである。

「【請求項１】

基板を検査する装置にあって、この装置は、ハンドリングシステム（３）、基板マガジンステーション（７）及び整合ステーション（１０）を有する

検査機を有する装置において、ハンドリングシステム、基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも２つの検査機（１；２；１１；１２；１４；１５）が提供されていること、各検査機（１；２；１１；１２；１４；１５）は、独立したモジュールとして構成されていること、および、各モジュールは、同じサイズの格子寸法であり、各モジュールは、互いに接合され得ることを特徴とする装置。」

２．刊行物の記載事項及び引用発明

これに対して、本願の優先日前に頒布された刊行物である刊行物１ないし３の記載事項及び引用発明は、上記第２　２．（２）に記載したとおりである。

３．対比・判断

本願発明は、本願補正発明における「各モジュールは、振動絶縁部、又は、位置制御されるプラットフォーム上に配置されている」との限定事項を省いたものであるから、本願発明の特定事項を全て含み、さらに他の特定事項を限定したものに相当する本願補正発明が、前記第２　２．（３）に記載したとおり、引用発明及び周知の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、当業者が容易に発明をすることができたものであるといえる。

４．むすび

以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明及び周知の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は、拒絶されるべきである。

よって、結論のとおり審決する。

平成２５年　４月１５日

審判長	特許庁審判官	新海　岳
	特許庁審判官	井上　茂夫
	特許庁審判官	松岡　美和

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）

この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。

〔審決分類〕 P 1 8 . 1 2 1 - Z （H O 1 L）

出訴期間として９０日を附加する。

審判長	特許庁審判官	新海 岳	8111
	特許庁審判官	松岡 美和	9617
	特許庁審判官	井上 茂夫	8920